Simple is Best!!

卓上型 基板最終外観検査装置

MO-EYE
TY-VISION Micro Optical - eye

■５分間検査データ作成
■虚報を抑えた高速検査
■驚きの低価格化を実現
□JPCA Show 2011 ⇒ 東6ホール 6Q - 13

太洋工業株式会社
www.taiyo-xelcom.co.jp
■ 本 社 ：〒640-8390 和歌山市有本 661 番地 TEL⇒073-431-6311（代） FAX⇒073-432-5469
■東京事業所：〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-3-3 九段下東急真サクラビル 7F TEL⇒03-3261-6301
海外拠点：上海・広州・タイ［バンコク：TAIYO TECHNOLEX(THAILAND)CO., LTD.］

JCU

荏原ユージライトは、高密度実装、微細化、最新パッケージング、環境対応など、次世代エレクトロニクスの課題に迅速に応えるために、表面処理薬品、各種プロセスや装置の開発・提供を通じて、「先端のものづくり」に貢献してまいります。

■電子部品用めっきプロセス
■プリント配線板用めっきプロセス
■半導体ウエハ対応めっきプロセス
■ドライプロセス
■表面処理装置

JPCA 2011 Show 第41回国際電子回路産業展　ブースNo. 東2ホール 2D-12

荏原ユージライト株式会社　〒110-0016 東京都台東区台東 4-19-9 山口ビル7 TEL.03-3833-0321 FAX.03-3833-5075
〈国内〉本社営業部、大阪支店、名古屋支店、高崎支店、浜松営業所、九州営業所、海外事業本部 〈海外〉中国、台湾、韓国、タイ、ベトナム、インド、メキシコ

JPCA Show 2011

きょう開幕

東京ビッグサイトで3日(金)まで

世界最大級の電子回路・実装技術の総合展「JPCA Show2011 第41回国際電子回路産業展」をはじめ、「ラージエレクトロニクスショー2011」、「2011マイクロエレクトロニクスショー 第25回最先端実装技術・パッケージング展」、「JISSO PROTEC2011 第13回実装プロセステクノロジー展」の4展示会が、きょう1日（水）から3日（金）までの3日間、東京・有明の東京ビッグサイトで開催される。開場時間は10時から17時まで。

JPCA Showは「プリント配線板技術展」と「半導体パッケージング・部品内蔵技術展」に、新設の「機器・半導体受託生産システム展」で構成され、日本電子回路工業会（JPCA）の主催。ラージエレクトロニクスショーは「プリンテッドエレクトロニクス展」と「部品・MEMS／デバイス産業総合資機材展」に、新設の「LED／OLED応用技術展」で構成され、JPCAと半導体産業新聞の共催となる。マイクロエレクトロニクスショーはエレクトロニクス実装学会（JIEP）、JISSO PROTECは日本ロボット工業会（JARA）の主催で、展示会全体の運営をJPCAが行う。入場料は1000円。ただし、招待券持参者および事前登録者は無料。

四つの展示会は、最先端機器を支える電子回路産業が国内外電子機器セットメーカーのアプリケーションサイド設計者に対し、今解決したい機能別対策技術である〝放熱、高速・高周波、パワーマネジメント、駆動コントロール〟といったソリューションを提供する場となる。展示会全体の出展規模は出展社数448社、出展小間1494小間となっている。

最先端技術・製品が一堂に

JPCA Show2011 3展構成で多彩な展示

JPCA Showは電子回路専門展示会として国際的に最も歴史があり、これまでも世界中に電子回路・実装技術を発信する場として高く評価されている。

展示会構成と出展内容は次の通り。

①「プリント配線板技術展 PWB Technology」＝片面・両面・多層プリント配線板、フレキシブルプリント配線板（FPC）、ビルドアップ配線板、金属ベース（銅・アルミニウムなど）プリント配線板、リジッド銅張積層板（CCL）、フレキシブル銅張積層板（FCCL）－などの製品・材料。

②「半導体パッケージング・部品内蔵技術展 Module Japan」＝リジッドサブストレート、ビルドアップサブストレート、COF／テープ自動ボンディング（TAB）、リジット系能動（受動）部品内蔵電子回路基板、フレキシブル系能動（受動）部品内蔵電子回路基板、微小電気機械システム（MEMS）埋め込み型部品内蔵電子回路基板、各種合金（鉄－ニッケル系、銅系）、ポリイミドフィルム／テープ－などの製品・材料。

③「機器・半導体受託生産システム展 EMS Japan」＝プリント配線実装基板、モジュール実装基板、挿入部品実装基板、チップ部品実装基板、ICパッケージ実装基板、ワイヤボンディング実装基板、TAB・COF実装基板－などの製品。

このほか、各種製造・検査装置が展示される。

ラージエレクトロニクスショー2011 低コスト・大量生産に道

ラージエレクトロニクスは、各種の方法によってパターンおよび素子を大面積に再現する技法。その応用製品として太陽光パネルや大型ディスプレーなど環境・エレクトロニクス製品の低コスト・大量生産の実用化に貢献するものとして期待されている。

同展の出展内容は次の通り。

①「プリンデッドエレクトロニクス技術展 PE Technology」＝プリンテッドエレクトロニクス基板、ディスプレー製品、次世代照明、太陽電池、燃料電池、導電性材料、半導体材料、導電性インク－などの応用製品・材料。

②「部品・MEMS／デバイス産業総合資機材展 Device Engineering」＝金属酸化膜半導体（MOS）ロジック／マイクロ／メモリー半導体、デジタルバイポーラ半導体、システムLSI、光MEMS、センサーMEMS、半導体シリコン、成膜・配線形成材料－などの製品・材料。

③「LED／OLED応用技術展 Solid－State Lighting」＝高輝度LED、有機EL、パワーIC／絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（IGBT）／インバーターなどハイパワーデバイスを実装する電子回路基板製品や実装済み電子回路実装基板、LED／OLED照明用デバイス、電極材料、レジスト材－などの応用製品・材料。

このほか、各種製造・検査装置が展示される。

2011マイクロエレクトロニクスショー 最先端実装技術を発信

実装要素技術の専門展である「マイクロエレクトロニクスショー」は、最新エレクトロニクス実装の開発や設計に携わる第一線技術者を中心とした最も歴史ある展示会で、最先端実装技術の発信の場として広く認知されている。

出展内容は、最先端将来技術を中心とした高密度・高周波実装技術応用製品、高密度サブストレート・イアンターポーザー、部品内蔵基板、半導体チップ、システムインパッケージ（SiP）／システムオンチップ（SoC）、表示・光デバイス／センサー、高密度実装関連材料－など。

◎**併催企画も多彩**

併催企画の「ものつくりフェスタ2011」は東6ホール内プレミアムステージで開かれる。基調講演は九つの基調講演と、一つの特別講演で構成される。このほか、次世代アプリ開発支援のセミナーと特別展示、「実体験コーナ」などが開かれる。

JIEP主催の「JIEP最先端実装技術シンポジウム」は、電子回路・実装技術専門家が取り組むべきテーマを網羅した内容で開催される。

シンポジウム内容は、「次世代3次元パッケージに対する新実装技術」「本格導入が近づく光インコネクト技術」「新分野応用に拡がるプリンタブルエレクトロニクス」など12セッション、計36セミナー。会場は東3ホール最先端実装技術シンポジウム会場。

このほかの併催企画は①出展者よる新製品・新技術紹介セミナー「NPIプレゼンテーション」②電子回路営業士・資格フォローアップセミナー③JIEP主催の大学・研究機関の研究成果発表「アカデミックプラザ」－などが開かれる。

有力各社の技術・製品（順不同）

上村工業

上村工業は表面処理のリーディングカンパニーとして研究開発を進めるとともに、廃棄物の削減や再生利用などの環境技術も追求する。ブースでは「ファインパターンと銅回路形成技術および、ファイン実装とコスト低減を実現する最終表面処理」をテーマに展示。垂直連続搬送メッキ装置「U－VCP」の実機を紹介する。また、ナレーターによるプレゼンテーション「銅ワイヤボンディング可能な銅上の新規パラジウム／金工程製品の紹介」を、3日13時30分から東6ホールのNPIプレゼンテーション会場で予定している。

HIOKI

HIOKIはJPCA Showの「半導体パッケージング・部品内蔵技術展」に出展する。

半導体パッケージ基板検査装置「ベアボードハイテスタ1231」と「X－Y Cハイテスタ1116」、データ編集機「EPR－LINE」、基板検査に有用な各種計測器や低コストで省エネ対策ができるデマンド監視装置など4テーマの展示を行う。特に、ベアボード検査機の新製品「X－Yベアボードハイテスタ FA1275」は基板検査の無人化運転を強力にサポート。同展で「FA1275」のインライン装置を展示する。

“つなぐ”テクノロジーで未来をひらく

Fujikura

株式会社フジクラ
〒135-8512 東京都江東区木場1-5-1
http://www.fujikura.co.jp
小間番号（5L-02）に出展しております

UYEMURA

ウエムラブース展示テーマ

「ファインパターンと銅回路形成技術」&
「ファイン実装とコスト低減を実現する最終表面処理」

ファインパターン銅回路形成技術

電子機器の小型化・高機能化により銅回路の更なる高密度化および高速化が求められています。このようなプリント配線板の銅回路形成では「ロープロファイル絶縁樹脂への高密着性を実現したデスミアプロセス」、「ファインパターン形成に適した薄く均一な下地無電解銅めっきプロセス」、「穴埋め性および膜厚分布の均一性に優れたビアフィル電気銅めっき」等が求められています。
今回の展示では、ファインパターン銅回路形成に求められるこれらの技術を提案しています。

コストダウンと実装信頼性を両立する表面処理技術

金価格高騰に伴う実装プロセスに於ける脱金の検討と、実装パッドの微細化に対応する検討が進んでいます。この脱金プロセスの実例として、ボンディングワイヤに銅や銀が使用され始めています。そして50μm以下の実装パッドへの表面処理についても検討がされています。
今回の展示では、コストダウンと実装信頼性を両立できる表面処理技術を提案しています。

他にウエムラブース内では、垂直連続搬送めっき装置（U-VCP）の実機展示を行います

☆ NPIプレゼンテーション（出展社製品技術セミナー）
■日　時：6月3日(金)13:30～14:00
■会　場：東6ホール　NPIプレゼンテーションB会場（入場無料）
■タイトル：銅ワイヤボンディング可能な銅上の新規パラジウム／金工程製品の紹介
■問い合わせ先：cpd@uyemura.co.jp

東2ホール 2I-09でお待ちしております。

上村工業株式会社
http://www.uyemura.co.jp
本 社 〒541-0045 大阪市中央区道修町3-2-6 ☎06-6202-8871
支 社 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12-7 ☎03-5645-2525
支 店 〒451-0044 名古屋市西区菊井1-20-11 ☎052-571-5381
海 外 米国・香港・中国・台湾・韓国・シンガポール・マレーシア・タイ

JIEP 2011 マイクロエレクトロニクスショー　東3ホール 3O-04
第25回 最先端実装技術・パッケージング展 ●会場：東京ビッグサイト ●会期：6/1(水)～6/3(金)

品質と信頼のはんだ付け ジャパンユニックス
JAPAN UNIX
口本 社 〒107-0052 東京都港区赤坂2-21-25 TEL:03-3588-0551(代) FAX:03-3588-0554 URL www.japanunix.co.jp
■熊本テクノセンター TEL:096-287-4501(代) FAX:096-287-4503 ■関西支店・大阪営業グループ TEL:06-6190-4580 FAX:06-6190-4581 ・名古屋営業所 TEL:052-679-2111(代) FAX:052-679-2112